

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年6月11日(11.06.2020)



(10) 国際公開番号

WO 2020/116336 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) G03F 7/037 (2006.01)
G03F 7/027 (2006.01) G03F 7/20 (2006.01)
G03F 7/029 (2006.01) G03F 7/40 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2019/046709
- (22) 国際出願日: 2019年11月29日(29.11.2019)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2018-228557 2018年12月5日(05.12.2018) JP
- (71) 出願人: 富士フイルム株式会社 (FUJIFILM CORPORATION) [JP/JP]; 〒1068620 東京都港区西麻布2丁目2番30号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 青島 俊栄 (AOSHIMA Toshihide); 〒4210396 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士フイルム株式会社内 Shizuoka (JP).
山▲崎▼ 健太 (YAMAZAKI Kenta); 〒4210396 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士フイルム株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人特許事務所サイクス (SIKS & Co.); 〒1040031 東京都中央区京橋一丁目8番7号 京橋日殖ビル8階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) Title: PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PATTERN FORMING METHOD, CURED FILM, MULTILAYER BODY AND DEVICE

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、パターン形成方法、硬化膜、積層体、及び、デバイス

(57) Abstract: The present invention provides: a photosensitive resin composition which contains at least one precursor that is selected from the group consisting of polyimide precursors and polybenzoxazole precursors, a compound having a sulfite ester structure, and a radical photopolymerization initiator, and which satisfies at least one condition among the conditions 1-3 described below; a pattern forming method which uses a photosensitive film that is formed from this photosensitive resin composition; a cured film which is formed from this photosensitive resin composition; a multilayer body which comprises this cured film; and a device which comprises this cured film or this multilayer body. Condition 1: The precursor contains a radically polymerizable group. Condition 2: The compound having a sulfite ester structure contains a radically polymerizable group. Condition 3: The photosensitive resin composition additionally contains a compound containing a radically polymerizable group, said compound being other than the precursor and the compound having a sulfite ester structure.

(57) 要約: ポリイミド前駆体及びポリベンゾオキサゾール前駆体よりなる群から選択される少なくとも1種の前駆体、亜硫酸エステル構造を有する化合物、及び、光ラジカル重合開始剤を含み、下記条件1～条件3の少なくとも1つを満たす感光性樹脂組成物、上記感光性樹脂組成物により形成された感光膜を用いるパターン形成方法、上記感光性樹脂組成物から形成される硬化膜、上記硬化膜を含む積層体、及び、上記硬化膜又は上記積層体を含むデバイス; 条件1: 上記前駆体がラジカル重合性基を含む; 条件2: 上記亜硫酸エステル構造を有する化合物がラジカル重合性基を含む; 条件3: 上記感光性樹脂組成物が、上記前駆体、及び、上記亜硫酸エステル構造を有する化合物以外のラジカル重合性基を含む化合物を更に含む。

WO 2020/116336 A1

[続葉有]

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

— 国際調査報告（条約第21条(3)）